

2015年度精密工学会秋季大会学術講演会講演募集について

1. 期 日 平成27年9月4日（金）～6日（日）
2. 会 場 東北大学 川内北キャンパス（仙台市青葉区川内41）
3. 講演申込開始 平成27年5月11日（月）9時から
4. 講演申込締切 平成27年5月30日（土）17時まで
5. 講演論文原稿締切 平成27年6月26日（金）17時まで
6. 講演論文公開予定 平成27年8月20日（木）（講演論文集CD-ROM発行日）
7. 講演申込費締切日 平成27年8月21日（金）までにお納め下さい。

8. 登壇資格

1) 個人会員（正会員・学生会員・学生会員 Web 級・名誉会員）、賛助会員所属の非個人会員および非会員の方の登壇が可能です。

2) 登壇者を代表として申し込んでいただきますが、講演論文原稿での著者の順番はこれに従う必要はありません。

9. 講演申込について

1) 登壇者のお名前で受け付けます。講演費用の請求、郵送物の送付は登壇者に行います。また、WEB へのアクセスも登壇者に限りますので、お申込後にやむを得ず登壇者を変更される場合は、必ずご連絡をお願いいたします。

2) 今大会では、学生によるポスターセッションを大会3日目の午後に実施します。学生の方が登壇者となって口頭発表されたものについて、これと同じ内容の研究成果をポスターでも発表していただくものです。発表を希望されるすべての学生の方の参加が可能です。

口頭発表とポスター発表の両方を行っていただきますが、ポスター発表には、充実した議論ができる点で、口頭発表に勝るものがあります。精密工学の将来を担う学生が一堂に会し、お互いのコミュニケーションをとり、精密工学分野の全体像を深く知る機会にさせていただくものです。若手研究者の育成、モノづくりを支える精密工学の将来に亘っての発展に、大いに資するものと考えております。奮ってのご参加をお願いいたします。優秀なポスター発表には、「ベストポスタープレゼンテーション賞」を大会実行委員長より発表者に授与します。項目15をご参照ください。

3) 講演申込は、すべて精密工学会ホームページから行っていただきます。講演申込締切期日を厳守してください。締切後直ちにプログラム編成を行いますので、遅れたものは理由を問わず受け付けません。なお、精密工学会ホームページには講演募集に関する最新情報を掲載します。

- 4) 申込先 <http://www.jspe.or.jp/>（精密工学会ホームページ）
（問合せ先）公益社団法人 精密工学会 大会係
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-5-9 九段誠和ビル2階
電話：03-5226-5191 E-mail：jspe_taikai@jspe.or.jp

5) 講演申込は1件につき1通登録してください。

6) 講演申込には下記の費用が必要です（費用はすべて税込）。なお、ポスター発表は講演件数に加えません（無料）。

7) 非会員の方で、個人会員としての登壇を希望される場合は、講演申込期間中に入会手続きをお願いいたします。

※2014年度秋季大会より下記金額に変更となりましたのでご了承の程よろしくお願いたします。

登壇者会員区分	申込件数	講演費	備 考
正 会 員	1 件目	11000 円	登壇者の大会参加費，講演論文集 CD-ROM，アブストラクト集含む
	2 件目以降	6000 円	同一登壇者が 2 件目以降の講演を申し込む場合，1 件毎に講演費が必要です
学生会員・ 学生会員 Web 級	1 件目	5000 円	登壇者の大会参加費，アブストラクト集含む ※講演論文集 CD-ROM は別途ご購入下さい。
	2 件目以降	5000 円	同一登壇者が 2 件目以降の講演を申し込む場合，1 件毎に講演費が必要です
賛助会員に所属 する非個人会員	1 件目	11000 円	登壇者の大会参加費，講演論文集 CD-ROM，アブストラクト集含む
	2 件目以降	6000 円	同一登壇者が 2 件目以降の講演を申し込む場合，1 件毎に講演費が必要です
非会員	1 件目	17000 円	登壇者の大会参加費，講演論文集 CD-ROM，アブストラクト集含む
	2 件目以降	12000 円	同一登壇者が 2 件目以降の講演を申し込む場合，1 件毎に講演費が必要です

学生非会員	ご入会されない方：非会員扱いとなります。
	講演申込に伴いご入会される方：学生会員・学生会員 Web 級扱いとなります。 <学生会員へご入会の場合> 入会金 200 円+会費 6000 円+講演費 5000 円 合計 11200 円 (税込) <学生会員 Web 級へご入会の場合> 入会金 0 円+会費 3600 円+講演費 5000 円 合計 8600 円 (税込)

送金方法：現金書留・郵便振替・銀行振込

郵便振替：00180-3-6115 公益社団法人精密工学会

銀行振込：みずほ銀行 九段支店 普通預金 口座番号 8047788 公益社団法人精密工学会

7) 講演論文原稿は，PDF 原稿の書き方を参考に作成し，原稿締切日までに指定の WEB ページから提出してください。

8) 講演論文原稿および口頭発表に用いる言語は日本語または英語といたします。

9) 講演論文集 CD-ROM に収録された論文の著作権およびアブストラクト集に掲載される概要の著作権は公益社団法人精密工学会に帰属します。著作権には複製権，翻案権，翻訳権を含みます。

10. 講演申込の方法

1) 講演申込は，精密工学会ホームページでフォームに沿って登録して下さい。

2) 同一題目の第 1 報～第 n 報には必ず副題を入れてください。

3) 講演要旨はそのままアブストラクト集に収録します。講演要旨には図表は掲載できません。研究内容が把握できるわかりやすい文章を 200 字以内で書いてください。

4) 講演希望セッションについて

今大会における講演セッション一覧は別紙の通りです。一覧に記載のキーワードはあくまでもセッションを構成するための「セッションキーワード」です。文献検索用のキーワードではありませんので，ご理解下さい。

申し込みの際は，所定欄に記載された講演希望のセッション名を必ず選択して下さい。選択漏れや選択ミ

スがありますとご希望のセッションにまわりませんのでご注意ください。

5) 今回は学生を対象にポスターセッションを行います。ポスター発表を希望するか、しないかの選択の項目があります。登壇者が学生の場合のみ、この項目に書き込んでください。

1 1. プログラムについて

プログラム編成は、その編成権を学術交流委員会がもち、また責任をもって行います。その結果、ご希望のセッションとは異なるセッションでの発表になることがありますので、予めご承知おきください。また、プログラムは原則として変更できません。

1 2. 講演発表に関するお願いと注意

- 1) 同一講演者（同一登壇者）が同一テーマ種別で3件以上の講演をご遠慮ください。
- 2) 同一題目で3件以上の講演をご遠慮ください。
- 3) 講演で使用可能な機器はプロジェクタです。パソコンは各自でご持参ください。設定・調整は各講演のセッション開始前をお願いします。パソコン不良に伴う講演トラブルについては、登壇者の責任で対処していただくようお願いします。

1 3. 登壇者変更および講演申込の取消について

- 1) 講演申込時の題目・登壇者の変更は原則として認めません。やむを得ず変更される場合は、必ずご連絡をお願いいたします。ご連絡のない場合は、講演申込時の題目・登壇者情報をプログラムに記載いたします。
- 2) 講演申込締切日を過ぎての申込キャンセルは原則として認めません。必ず講演論文を提出し発表を行っていただきます。 登壇者が病気や事故等のやむを得ない理由で発表出来ない場合は、連名者が代わりに発表するものとします。この点については、講演申込の前に、連名者に必ずご確認ください。

1 4. ベストプレゼンテーション賞の授賞について

特に優れた講演発表について「ベストプレゼンテーション賞」を登壇者にお出しします。本賞は35歳までの若手登壇者を審査対象（キーノートスピーカを除く）として、講演総数の概ね3%に贈賞いたします。

発表当日に、①研究の新規性・発表内容、②発表の構成・方法、③適切な質疑応答、の3項目についてセッション座長および審査員1名（計2名）で採点を行い、その集計結果と講演論文内容を参考として、事業部会学術交流委員会で最終選考いたします。受賞者には選考終了後、表彰状をお送りいたします。

詳細につきましては、精密工学会ホームページ（<http://www.jspe.or.jp/>）に掲載していますのでご覧ください。

1 5. ベストポスタープレゼンテーション賞(学生対象)の授賞について

今大会では、学生によるポスターセッションを大会3日目の午後において実施し、優れたポスター発表について「ベストポスタープレゼンテーション賞」を大会実行委員長より発表者に贈賞します。選考基準はポスターの分かりやすさ、説明など、発表技術が中心で、ポスターセッション参加者の投票により上位5%を選考する予定です。受賞者には大会終了後、表彰状をお送りいたします。

2015年度精密工学会秋季大会学術講演会 講演セッション一覧

今大会における講演セッション一覧は以下の通りです。講演を希望する分類コード+セッション名(小分類)を必ず選択してください。選択漏れや選択ミスがありますとご希望のセッションにまわりませんのでご注意ください。

大分類	OS/一般	分類コード	セッション名(小分類)	セッションキーワード	オーガナイザー
A: 設計・生産システム					
設計論	OS	A01	設計の方法論	設計プロセス, 設計手法, 設計教育, 設計モデル, 設計評価, サービス設計	下村 芳樹(首都大), 妻屋 彰(神戸大), 藤井 信志(神戸大), 野間口 大(大阪大), 千葉 龍介(旭川医科大), 木見田 康治(首都大)
	一般	A02	設計の方法論一般	設計論, 設計知識, 最適化, ロバスト設計, 信頼性設計, QFD(Quality Function Development), DFX (Design for X), プロダクトファミリー, VR(Virtual Reality)応用	
形状処理	OS	A03	デジタルスタイルデザイン	意匠設計(スタイルデザイン), リバースエンジニアリング, 3次元形状モデリング技術, 意匠形状評価技術	小林 一也(富山県立大), 青山 英樹(慶應義塾大)
	OS	A04	形状モデリングの基礎と応用	形状モデリングと製造支援, CAGD, エンジニアリングシミュレーション, コンピュータグラフィックス	大竹 豊(東京大), 金井 崇(東京大)
	OS	A05	サイバーフィールド構築技術	3次元環境計測データからのモデル構築, 大規模形状計測データに対する情報処理, フィールド計測技術(画像, レーザなど), サイバーフィールドの利活用と業務支援, 点群処理, 形状再構成, 3次元計測, 移動計測, 大規模設備のモデリング	増田 宏(電気通信大), 伊達 宏昭(北海道大), 小野里 雅彦(北海道大)
持続可能なものづくりのためのライフサイクルエンジニアリング	OS	A06	持続可能なものづくり	持続可能社会, サステナブル・マニュファクチャリング, 循環生産, インバース・マニュファクチャリング	高田 祥三(早稲田大), 梅田 靖(東京大), 増井 慶次郎(産総研)
		A07	ライフサイクル設計・評価	ライフサイクル設計, エコデザイン, ライフサイクルビジネス設計, ライフサイクルPSS設計, ライフサイクル評価, LCA, 環境負荷	
		A08	ライフサイクルマネジメント・保全	ライフサイクルマネジメント, メンテナンス	
		A09	ライフサイクルプロセス技術	リサイクル, リユース, 品質検査, クリーニング技術	
		A10	環境対応生産システム・環境対応製造プロセス	エコマシニング, 省エネルギー, 省資源, 環境対応生産, 環境負荷低減技術, 環境対応スケジューリング, 生産システムの環境影響評価	
生産システム	OS	A11	マイクロ生産機械システム	マイクロ工作機械, マイクロファクトリー, マイクロ組立	岡崎 祐一(産総研), 木村 広幸(湘南工科大)
	一般	A12	生産システムのエンジニアリング	スケジューリング, 工程計画, 新生産システム概念, 生産システム設計・評価, サプライチェーン, デジタルファクトリー, 企業導入事例	
	一般	A13	CAM	CAD, CAM, CAE, CAT, オープン開発, カーネル内製化	
	一般	A14	生産システム一般	生産計画・管理, 品質管理, 在庫管理, 生産設備, 経営工学, 安全工学, 生産情報工学, 人間工学・ヒューマンインターフェース, SCM(Supply Chain Management), リバースエンジニアリング, インバースマニュファクチュアリング	
生産原論	OS	A15	生産技術教育・環境	工学教育, 技術者倫理, 生産哲学, モノづくり	伊藤 昌樹(関東職能開発大), 河西 敏雄(埼玉大/河西研磨技術特別研究室), 伊藤 伸英(茨城大), 池野 順一(埼玉大)
		A16	生産技術史	歴史, 再現実験, 確認実験, 時間的トランスファ・エンジニアリング	
		A17	生産と人間	感性, 技術者論, 技能者論, 技能伝承, 先端技術	
B: 加工技術・材料					
切削	OS	B01	工作機械の高精度・高機能化技術	工作機械, 高速化, 高精度化, 高機能化, 知能化, システム化	白瀬 敬一(神戸大), 松原 厚(京都大), 森本 喜隆(金沢工業大), 家城 淳(オークマ)
	OS	B02	高効率・高精度化のための切削工具	切削現象, 切削加工, 切削工具, 被削性, 難削材料, 快削化	白杵 年(島根大), 新谷 一博(金沢工業大), 関谷 克彦(広島大), 笹原 弘之(東京農工大)
	OS	B03	穴加工および穴形状精度の測定	穴加工, 穴精度測定, 掘削	甲木 昭雄(九州大)
	OS	B04	エンドミル加工技術	エンドミル加工, 切削機構, 切削性能, 切削シミュレーション	安齋 正博(芝浦工業大), 松村 隆(東京電機大), 吉川 浩一(九州工業大), 岩部 洋尊(新潟大)
	一般	B05	切削加工一般	工具摩耗, 切りくず, 切削抵抗, 仕上げ面性状, 切削温度, 切削油剤, 被削性, 難削材, 切削機構, 超精密・マイクロ切削, 治工具, 切削加工機	
	一般	B06	超精密マイクロ機械加工	超精密加工, 微細加工, 超精密工作機械	
生産技術	OS	B07	多軸制御加工計測	多軸制御, 加工, 計測, 運動精度, 複雑形状創成, 形状創成CAM, 巧妙加工	森重 功一(電気通信大), 竹内 芳美(中部大), 茨木 創一(京都大)
	OS	B08	金型設計・生産技術	金型CAD/CAM/CAE, 金型加工, プラスチック成形加工, ダイカスト成形	村田 泰彦(日本工業大), 榎原 弘之(九州工業大), 新川 真人(岐阜大), 福島 祥夫(群馬産技ゼ)
	一般	B09	環境対応加工	エコマシニング, 省エネルギー, 省資源, 環境対応生産, 環境負荷低減技術	

大分類	OS/一般	分類コード	セッション名(小分類)	セッションキーワード	オーガナイザー
研削・研磨・仕上げ加工	OS	B10	高性能高機能研削とその最適化	高性能研削, 高機能研削, 研削現象, 研削機構, 加工計測, 超砥粒砥石, ソルレーイング, ドレッシング, 研削盤	田辺 実(明治大), 市田 良夫(CBN&Dナノ加工研究所), 太田 稔(京都工芸繊維大), 澤 武一(芝浦工業大), 大橋 一仁(岡山大), 坂本 治久(上智大)
	OS	B11	ナノ表面研削/ELID研削	新研削法, 鏡面研削, 超精密研削, ELID, 表面改質, 複合加工, イオンショット	大森 整(理化学研), 林 健民(群馬大), 伊藤 伸英(茨城大), 上原 嘉宏(理化学研), 水谷 正義(東北大)
	OS	B12	切断・割断加工	切断, 割断, 遊離砥粒, 固定砥粒, レーザ・放電・ウォータージェット・化学援用加工等	坂本 智(横浜国立大), 諏訪部 仁(金沢工業大)
	OS	B13	砥粒加工の新展開	ホリシング・ラッピング, 高平坦研磨加工, 固定砥粒研磨加工, 超精密研磨加工, メカノケミカル研磨加工, 噴射加工, 工作物の高精度保持	榎本 俊之(大阪大)
	OS	B14	新研磨・仕上げ加工法	新研磨・仕上げ加工法, 材料設計, シミュレーション, 電界利用, 電荷移動メカニズム	須田 聖一(静岡大), 赤上 陽一(秋田県産技校), 久保 百司(東北大)
	OS	B15	プラナリゼーションCMPとその応用	プラナリゼーションCMP, 超精密研磨, 半導体材料, 消耗材技術(スラリー・パッド・コンディショナー), 装置化技術, デバイスプロセス, 評価技術, ラッピング・ホリシング, 鏡面・平坦化加工(含む研削), 複合・援用研磨, 新研磨・仕上げ加工法, その他	近藤 誠一(日立化成工業), 黒河 周平(九州大), 畠田 道雄(金沢工業大)
	OS	B16	ナノ精度表面創成法とその応用	ナノ精度加工, ナノ精度計測, 次世代光学素子, 次世代半島体基板	三村 秀和(東京大), 久保田 章亀(熊本大), 大橋 治彦(高輝度光科学研), 山村 和也(大阪大)
	一般	B17	研磨加工一般	研削, 研磨(ホリシング, ラッピング), 砥石, 砥粒, 電解研磨, 切断・スライシング, 研削・研磨加工機	
	一般	B18	磁場・電場援用加工	磁場・電場援用研磨(加工), 電気・磁気粘性流体利用加工	
曲面・微細形状の光学素子の設計・加工・計測プロセス ※こちらは大分類でひとつのオーガナイズドセッションですが、講演を希望する分類コード+セッション名(小分類)を選択してください。	OS	B19	自由曲面・微細形状の創成	曲面・微細加工, 機能性材料, 超精密加工, 超精密計測	山形 豊(理化学研), 森田 晋也(理化学研), 林 健民(群馬大), 古城 直道(関西大), 鈴木 浩文(中部大), 牧野 俊清(長津製作所), 福田 将彦(東芝機械), 三浦 勝弘(三鷹光器), 岡田 浩一(日進工具)
		B20	曲面・微細形状の光学素子の光学設計	光学設計, 光線追跡, 収差	
		B21	加工装置・制御・要素技術	超精密切削加工装置, 超精密研削装置, 超精密研磨装置	
		B22	加工ツール	ダイヤモンド工具, cBN工具, マイクロ工具	
		B23	超精密加工の新プロセス	プロセス, 切削, 研削, 研磨, 計測, 補正加工	
		B24	加工現象・機構, シミュレーション	延性モード加工, 切りくず創成メカニズム, 加工力の解析, 切削力	
		B25	計測評価技術	非球面計測, 机上測定, 接触式測定, 非接触測定, レーザ光	
		B26	曲面・微細形状その他	単結晶材料の加工, 金型加工, 射出成形, ガラス成形, UV成形, ソルレーイング, ドレッシング	
電気・化学加工, 粒子ビーム加工	OS	B27	放電加工・電解加工	放電加工, 電解加工, レーザ加工	武沢 英樹(工学院大), 早川 伸哉(名古屋工業大)
	OS	B28	レーザー加工	レーザー加工, レーザ, レーザ併用加工, レーザ支援加工, 光応用加工	岡本 康寛(岡山大), 比田井 洋史(千葉大), 布引 雅之(兵庫県立大)
	OS	B29	超音波振動を援用した加工技術	超音波振動切削, 超音波振動研削, 超音波振動研磨	神 雅彦(日本工業大), 磯部 浩己(長岡技術科大)
	一般	B30	電気加工, ビーム加工, 化学加工一般	電解加工, 放電加工, ビーム加工, レーザ加工化学加工一般	
物理・化学的加工によるマイクロ・ナノ構造創成	OS	B31	マイクロ・ナノ加工とその応用	マイクロ・ナノ加工, 表面特性・機能, エッチング, イオンビーム, インプリント関連, 広義の複合加工, 自己組織化, マイクロナノ材料, その他の新規加工技術	川堰 宣隆(富山県工技七), 金子 新(首都大), 比田井 洋史(千葉大)
アディティブマニュファクチャリング	OS	B32	機能形状創製(付加製造, 3Dプリンティング, MID)	3Dプリンティング, Additive Manufacturing, MID, ラビッドプロトタイプング, 積層造形	新野 俊樹(東京大)
表面工学	OS	B33	機能薄膜・表面処理	薄膜形成, 表面処理技術, 特性・機能	垣内 弘章(大阪大), 井上 尚三(兵庫県立大), 安武 潔(大阪大), 大竹 尚登(東京工業大)
	一般	B34	マイクロ・ナノファブリケーション一般	マイクロファブリケーション, ナノファブリケーション, AFM加工, プローブ加工	
	一般	B35	表面工学一般	表面処理, 表面特性・機能, 摩擦・摩耗, 潤滑	
機械材料	一般	B36	機械材料一般	機械材料, 電子・光学材料, 微粒子, ナノ材料	
塑性加工一般	一般	B37	塑性加工	塑性加工, 金型, プレス加工	

大分類	OS/一般	分類コード	セッション名(小分類)	セッションキーワード	オーガナイザー
C:ロボティクス・メカトロニクス, 知的システム					
精密・超精密位置決め ※こちらは大分類でひとつのオーガナイザーセッションですが、講演を希望する分類コード+セッション名(小分類)を選択してください。	OS	C01	位置決め装置の設計・開発	直進位置決め機構, 回転位置決め機構, パラレルメカニズム, 革新的位置決め・運動制御装置, 位置決め・運動制御機構とその応用	佐藤 海二(東京工業大), 真崎 和生(ニコン), 佐藤 隆太(神戸大)
		C02	機械要素	軸受, 案内, 動力伝達要素, ボールねじ, 拡大・縮小機構, 革新的機械要素技術	
		C03	センサ・アクチュエータ	電磁モータ, 静電モータ, リニアモータ, サーボアクチュエータ, 革新的駆動技術, エンコーダ, 加速度計, レーザ変位計, レーザトラック, 革新的計測技術	
		C04	位置決め制御(間欠位置決め・連続位置決め)	間欠位置決め, 連続位置決め, 円運動, コーナ部運動, 同期制御, 粗微動制御, 振動制御, 数学モデル, 摩擦モデル, 摩擦補償, 革新的位置決め・運動制御技術	
ロボティクス・メカトロニクス	OS	C05	新しいロボットシステム	ロボティクス, メカトロニクス, センサ, アクチュエータ	杉 正夫(電気通信大), 関 啓明(金沢大), 金森 哉史(電気通信大)
	OS	C06	次世代センサ・アクチュエータ	圧電アクチュエータ, 超磁歪アクチュエータ, 熱変形アクチュエータ, 高分子アクチュエータ	森田 剛(東京大), 古谷 克司(豊田工業大), 岩附 信行(東京工業大)
	OS	C07	スマートエンジニアリングシステムの設計・応用	群知能, 進化と学習, マルチエージェント, 複雑システム	林 朗弘(九州工業大), 香村 茂(首都大), 山本 雅人(北海道大)
	一般	C08	医用・福祉ロボティクス・人間工学	ヒューマンサポート工学, 生体工学, 医用工学, バイオテクノロジー, 福祉工学, ヒューマンインターフェース, 生体計測, 動作解析, スポーツ工学, 医用機器, 福祉機器, 人間共存型機器, 生活支援機器	
	一般	C09	ロボティクス一般	ロボット, 位置決め・送り, アクチュエータ, センサ, 機構学, 機械要素, 軸受, 減速機, 組立, 振動	
	一般	C10	メカトロニクス一般	センサ, 制御, 知能, 画像処理, インテリジェント制御, 人工知能	
マイクロ/ナノ/バイオシステム	OS	C11	N-MEMS製造・応用と信頼性	MEMS デバイス応用, デバイス・材料評価, MEMSデバイス作製技術, アセンブリ/パッケージング, マイクロ接合, ナノインプリント	高木 秀樹(産総研), 小久保 光典(東芝機械), 日暮 栄治(東京大), 生津 資大(兵庫県立大), 尹 成園(産総研)
	OS	C12	マイクロ/ナノシステム	マイクロ/ナノシステム, マイクロメカニズム, マイクロマシン, マイクロ/ナノメカニズム, MEMS/NEMS, MOEMS/NEOMS	堀江 三喜男(東京工業大), 大平 文和(香川大), 伊藤 高廣(九州工業大), 中里 裕一(日本工業大), 松井 伸介(千葉工業大)
	OS	C13	バイオ・医療への応用展開	生体分子・細胞マニピュレーション, 生体分子・細胞機能解析, バイオイメージング, バイオアセンブリ, 細胞培養, バイオマテリアル, バイオ機能表面, バイオデバイス, バイオMEMS, マイクロTAS, 医用センサ, 医用マイクロメカニズム, マイクロノードル, マイクロサージャリー, マイクロインジェクション, 微細加工	初澤 毅(東京工業大), 柴田 隆行(豊橋技科大), 早瀬 仁則(東京理科大), 金子 新(首都大), 青柳 誠司(関西大), 榎谷 和義(東海大), 藤井 輝夫(東京大)
	一般	C14	マイクロシステム一般	MEMS, マイクロデバイス, マイクロセンサ, マイクロアクチュエータ, マイクロ検査システム, マイクロアセンブリ	
D:計測・品質管理					
精密計測	OS	D01	メカノフotonics	光応用技術(三次元計測, 形状計測, 光センシング, 生体・医用計測, 高速度計測, 機器光学, オプトメカトロニクス), イメージング・光情報処理(光イメージング, デジタルオプティクス, 光物性), 光学新領域(プラズモン, テラヘルツ, X線, 中赤外等も含む)	加藤 純一(理化学研), 安達 正明(金沢大), 稲 秀樹(キヤノン), 大谷 幸利(宇都宮大), 水谷 康弘(大阪大)
	OS	D02	表面ナノ構造・ナノ計測	表面ナノプロセス, ナノストラクチャ, 物理計測, 走査型プローブ顕微鏡技術, ナノ・マイクロ集積システム	有馬 健太(大阪大), 清水 裕樹(東北大), 桑原 裕司(大阪大), 岩田 太(静岡大)
	OS	D03	知的精密計測	知的計測(計測アルゴリズム, 計測データ処理, 超解像, 光コム, 光干渉等), 幾何学量計測(変位, 角度, 寸法, 形状, 表面微細形状等), メトロロジー(不確かさ, トレーサビリティ, 計量標準, 校正等), 品質評価(欠陥検出, 光散乱等)	高増 潔(東京大), 笹島 和幸(東京工業大), 高谷 裕浩(大阪大), 清水 裕樹(東北大)
	OS	D04	画像センシング	画像処理, 検査, 位置合わせ, 認識, 検索, センシング, 3次元計測	中島 慶人(電力中央研), 中村 明生(東京電機大)
	一般	D05	応用計測	加工計測, 機上計測, インプロセス計測, 機械計測(力, 応力, 硬さ, 温度等)	
品質管理	一般	D06	品質管理一般		
E:その他					
技術史・教育一般	一般	E01	技術史・教育一般		
新領域・その他	一般	E02	新領域・その他		